

日本ドライ加工振興会 第1回技術セミナー  
金型分科会 第23回技術セミナー

ドライプレス加工の基礎と実用化への取組み

日時：22年8月25日（水） 9:30～17:00

場所：金属プレス会館6階会議室（〒130-8553 東京都墨田区両国4-30-7、

アクセス <http://www.tmsa.or.jp/access1.html>）

主催：日本ドライ加工振興会、東京都金属プレス工業会、日本塑性加工学会金型分科会

協賛：日本金型工業会東部支部、日本トライボロジー学会、日刊工業新聞社

趣旨：プレス加工において潤滑油は大変重要な役割を演じていますが、近年の環境負荷低減に対する意識の高まりから潤滑油を使わないドライプレス加工が注目されています。本セミナーでは、セラミックスやDLC（ダイヤモンドライクカーボン）膜、あるいは多結晶ダイヤモンド膜をドライプレス加工用工具に適用する場合に必要な基礎的な知識、及びその実用化への取組み状況について紹介します。

内容：	司会	午前の部	日進精機(株)	加藤忠郎
		午後の部	日本工業大学	野口裕之
9:30～9:50	ドライプレス加工への期待	山陽プレス工業(株)		檜垣昌子
9:50～10:30	プラズマCVD法によるDLC膜のコーティング法		神港精機(株)	寺山暢之
10:30～11:10	最近のダイヤモンド膜コーティング法		日本工業大学	竹内貞雄
11:10～11:50	最近のダイヤモンド膜研磨法		都産技研センター	横澤毅
	(11:50～12:40 昼食)			
12:40～13:20	最近のセラミックス製作技術		(株)日本タングステン	皆本鋼輝
13:20～14:00	セラミックス工具によるドライプレス加工の最前線		都産技研センター	玉置賢次
14:00～14:40	DLCコーテッド工具によるドライプレス加工の最前線		湘南工科大学	村木正芳
	(14:40～15:00 休憩)			
15:00～15:40	積層DLC膜の特性とドライプレス加工の最前線	芝浦工業大学		相澤龍彦
15:40～16:20	ダイヤモンドコーテッド工具によるドライプレス加工の最前線		湘南工科大学	片岡征二
16:20～17:00	総合討論	司会	(独)産業総合研究所	清水透

定員：60名、参加費：日本ドライ加工振興会・東京都金属プレス工業会・日本塑性加工学会金型分科会会員3,000円、協賛学協会6,000円、一般10,000円。なおセミナー終了後に講師を交えての懇親会を予定しています。ぜひご参加ください。会費3,000円

申込方法：「日本ドライ加工振興会第1回セミナー申込み」と題記し、(1)氏名、(2)勤務先・所属、(3)通信先（所在地、電話番号、FAX番号、e-mail）、(4)申し込み資格（主催会員、協賛会員、一般）を明記のうえ、7月31日までにE-mail又はFAXにて下記までお申し込みください。参加費は、当日会場受付にてお支払いください。

申込先：(社)東京都金属プレス工業会 専務理事 伊藤洸

電話：03-5624-1921 FAX：03-5624-1920 e-mail：[ito@tmsa.or.jp](mailto:ito@tmsa.or.jp)